划片刀

Nickel bond dicing blades

Our nickel blades are mainly for wafer dicing and package singulation.

半导体晶圆切割用镍基划片刀

Nickel Blades for Wafer Dicing

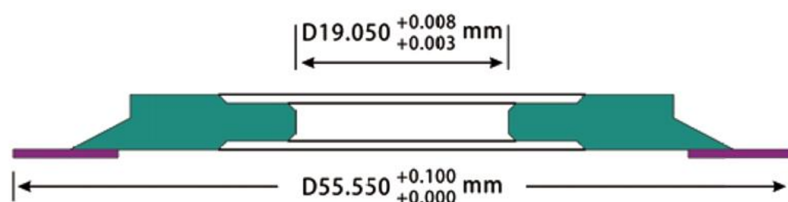
Main features：Stable dicing performance of narrow street wafers.

主要特点: 采用电铸镍基结合剂工艺，划片刀刀刃具有超高强度，刀刃超薄，满足半导体晶圆窄街区的划切需求。

Applications: Silicon wafer, compound semiconductor wafers (GaAs, GaP), oxide wafer (LiTaO3) and others.

适用加工材料:半导体硅晶圆、化合物半导体晶圆（GaAs、GaP 等）、氧化物半导体晶圆（LiTaO3 等）、其他材料。

Specification 规格



12A2 25×640 — 3000 — 70 — M

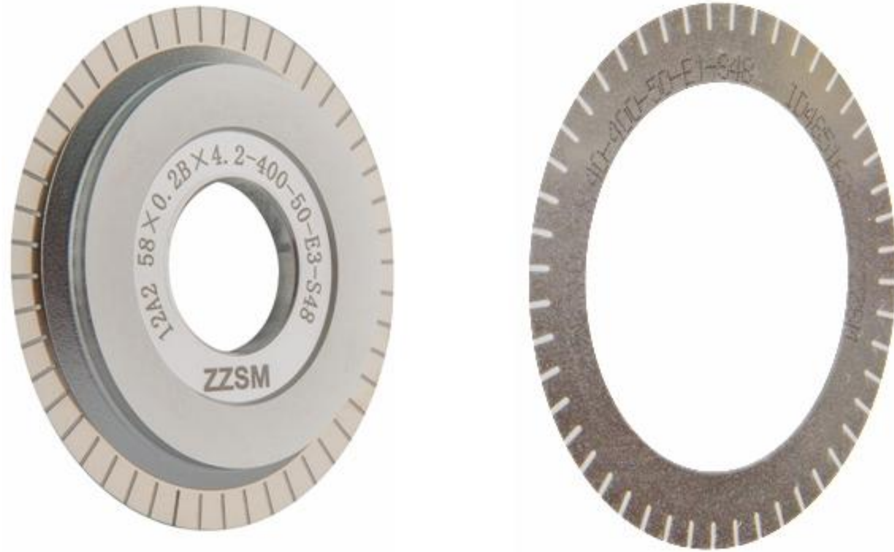
砂轮形状代号 Shape Code of Wheel	刀刃几何尺寸 Blade Dimension	金刚石粒度 Diamond Grit Size	金刚石浓度 Diamond Concentration	结合剂硬度 Bond Hardness
12A2	厚度 × 长度 Thickness × Exposure	5000# 4800# 4500# 4000# 3500# 3000# 2500# 2000# 1800# 1700# 1500#	30 50 70 90 110 130	S 软 Soft M 中 Medium H 硬 Hard

单位：um

厚度基本尺寸 Thickness(um)	刃长基本尺寸 Exposure(um) → 实际尺寸范围 Tolerance range	250 250~380	380 380~510	510 510~640	640 640~760	760 760~890	890 890~1020	1020 1020~1150	1150 1150~1270	1270 1270~1400	金刚石粒度 Grit Size	金刚石浓度 Diamond Concentration	结合剂硬度 Bond Hardness
15	10~15										5000 4800 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1800 1700 1500	50 70 90 110 130	S M H
20	16~20												
25	21~25												
30	26~30												
35	31~35												
40	36~40												
50	41~50												
60	51~60												
70	61~70												
80	71~80												
90	81~90												
100	91~100												
110	101~110												
120	111~120												

半导体封装切割用镍基划片刀

Nickel Blades for Package Singulation



Main features:A combination of nickel bond and larger size diamond grits provides long blade life performance.

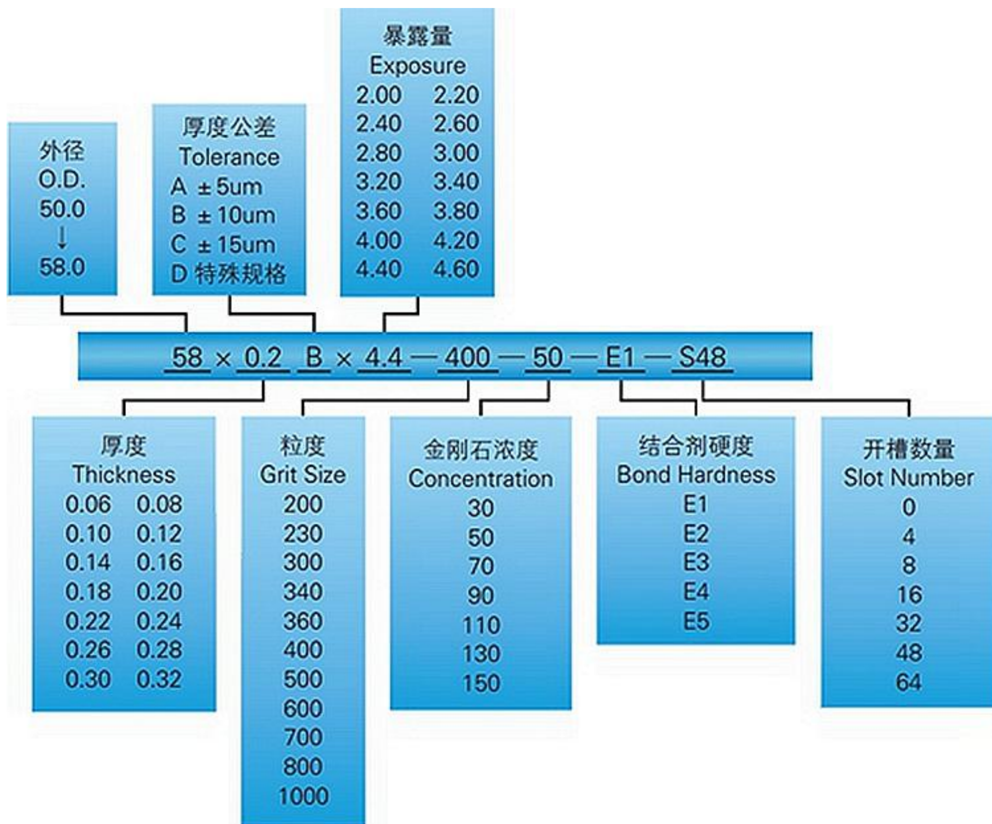
Applications:Alumina ceramics, EMC, PCB and various semiconductor package substrates.

主要特点:采用电铸镍基结合剂，配合粗粒度金刚石，实现超长寿命划切。

适用加工材料:氧化铝陶瓷、EMC（热固性树脂）、PCB（印刷电路板）等各种半导体封装基板。

Specification of hub blades for package dicing

半导体封装切割用镍基划片刀- 轮毂型 型号规格



Specification of hub-less blades for package dicing

半导体封装切割用镍基划片刀- 无轮毂型 规格型号